



**TIF® 050AB-WA** 是为高性能设备而设计的一种双组份导热吸波凝胶。在确保优异的EMI抑制能力的同时，且具备优良的导热性能，可满足对电磁干扰吸收和导热同时有要求的场景。其凝胶形态使得产品提供了应用灵活性和可变间隙适应，具有极好的压缩性和贴服性，能够适应大规模、自动化点胶施工，特别适合用于不规则表面、缝隙场景。

### 特性

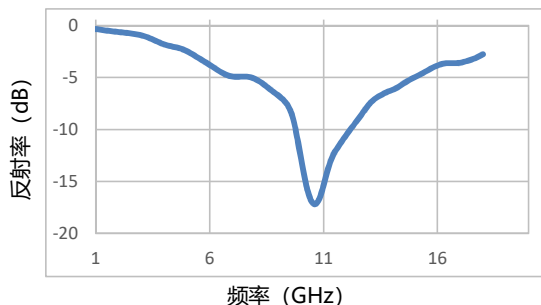
- 》导热与吸波双功能集成
- 》高柔软硅凝胶材质
- 》高粘度稳定体系，无填料迁移
- 》可轻松用于点胶系统自动化操作
- 》长期可靠性

### 应用

- 》路由器 / 交换机射频模块
- 》智能手机、平板、笔记本电脑的射频芯片
- 》新能源车 BMS 电池管理系统
- 》电源模块、工控主板
- 》激光器、传感器、高速传输接口

TIF® 050AB-WA 特性表		
未固化材料特性		
产品特性	典型值	测试方法
结构&成份	陶瓷及磁性粉填充硅材料	-
A组份颜色	灰色	目视
B组份颜色	灰色	目视
A组份粘度 (mPa·s)	6,000,000	GB/T 10247
B组份粘度 (mPa·s)	6,000,000	GB/T 10247
最小界面厚度 (mm)	0.15	-
混合比例	1:1	-
保存期限 (月)	12 (未开封)	-
固化条件		
操作时间 25°C	30 分钟	兆科测试
固化时间 25°C	2-4 小时	兆科测试
固化时间 100°C	30 分钟	兆科测试
固化后材料特性		
颜色	灰色	目视
硬度 (Shore OO)	60	ASTM D2240
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.6	ASTM D792
热阻抗 (°C·in <sup>2</sup> /W) @10psi	0.08	ASTM D5470
热阻抗 (°C·in <sup>2</sup> /W) @50psi	0.07	ASTM D5470
导热系数 (W/m·K)	5.0	ASTM D5470
建议使用温度范围 (°C)	- 40~200	-
阻燃等级	V-0	UL 94

### 反射率



### 产品规格

50 cc/支, 400 cc/支, 或用于自动化应用的定制包装。如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

如果您想了解更多导热材料的产品信息, 请访问我司官网。

#### 全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208

台湾: +886-2-2277-1007

加拿大: +001-604-2998559

越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科技术有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的, 产品规格可能因技术改动或优化而调整, 恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担, Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证, 亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。

